

■ 財務概況

財務概況

損益状況

当期の事業環境

2014年3月期は、中国で成長率が鈍化するなど新興国では成長の減速も見受けられましたが、米国は若干上向き、欧州でも景気持ち直しの動きが見られるなど、世界経済は総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。日本経済においても、景気刺激政策と世界経済の好転を背景に改善傾向を示しました。

当社の参画するエレクトロニクス産業においては、テレビやパソコンなどの製品需要は依然厳しい状況が続きましたが、新興国におけるスマートフォン・タブレットの需要拡大を中心にモバイル端末の出荷は堅調でした。こうしたモバイル端末の世界的な拡がりや、クラウドサービスの普及に伴うデータセンター向けサーバー需要の伸びを背景に半導体需要も拡大しました。これらを受けて、当社の顧客である半導体メーカーの設備投資も回復いたしました。

売上状況

事業環境の好転を受け、主力である半導体製造装置の売上が大幅に回復したため、当期の売上高は前期比23.1%増加の6,122億円となりました。

国内売上高は前期比36.4%増加の1,616億円、海外売上高は前期比18.9%増加の4,505億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の76.2%から73.6%に2.6ポイント低下しました。

なお、当期の受注高は前期比54.5%増加の6,962億円、当期末の受注残高は46.6%増加の2,651億円となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比21.2%増加の4,103億円でしたが、売上原価率は前期から1.1ポイント低下の67.0%となりました。

これにより売上総利益は前期比27.2%増加の2,019億円となり、売上総利益率は前期の31.9%から33.0%に上昇しました。

販売費及び一般管理費は、前期に買収した海外子会社4社が担当する分野の研究開発費の増加や、のれん償却費を含む費用が当期より全額算入されたこと、また、円安の影響により海外子会社の外貨建て費用の円換算額が増加したことにより、前期比16.1%増加の1,697億円となりましたが、売上の増加が販売費及び一般管理費の増加を上回ったため、連結売上高に対する比率は前期の29.4%から27.7%に低下しました。

これらの結果、営業利益は前期比156.6%増加の322億円、営業利益率は前期の2.5%から5.3%に上昇しました。

研究開発費

研究開発費は、前期比7.4%増加の787億円となりました。技術開発が当社の成長の源泉であるとの考えのもと、既存分野の強化のみならず、今後の成長が見込まれる新規分野にも投資を行いました。対売上高比率は、売上高が大きく増加したため前期の14.7%から12.9%に低下しました。

半導体製造装置分野では、さらなる微細化に対応するマルチパターンニング技術や、新しい三次元構造デバイスや新材料に対応する成膜技術、エッチング技術、洗浄技術などのキーテクノロジーの開発に取り組みました。また、次世代メモリの有力候補であるSTT-MRAM*用の製造装置開発や、先端パッケージング技術の開発にも注力しました。

FPD製造装置分野では、有機ELパネル製造用インクジェット描画装置の開発を行いました。

* STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory(低消費電力が期待できる磁気メモリ)

その他収益(費用)および当期純利益(損失)

当期は、主な収益として、受取利息及び受取配当金32億円、補助金収入12億円を計上しました。主な費用としては、PV製造装置事業の将来のキャッシュ・フローを見直したことによるのれん等の減損損失328億円、2012年5月に買収完了したTEL NEXX, Inc.の事業計画を見直したことによるのれん等の減損損失50億円、拠点再編計画の決定に伴う固定資産の減損損失83億円等、合計470億円の減損損失を計上しました。これにより、その他収益(費用)は純額で440億円の費用(前期は52億円の収益)となりました。

この結果、税金等調整前当期純損失は118億円(前期は178億円の利益)、当期純損失は194億円(前期は61億円の利益)を計上することとなりました。1株当たり当期純損失は108.31円(前期は33.91円の利益)となりました。

包括利益

当期は、円安の影響により為替換算調整勘定69億円を計上したことに加え、その他有価証券評価差額金14億円を計上しましたが、前述の通り当期純損失が194億円、少数株主損益調整前当期純損失が192億円であったことから、包括利益は109億円の損失(前期は158億円の利益)となりました。

配当政策および当期配当金

当社は、業績連動型・収益対応型の配当を株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%を目

途とする配当を実施しています。当事業年度の年間配当金につきましては、本配当政策に変更ありませんが、業績連動の方針に加え、当社グループの財務状況及び世界の金融・経済動向等も鑑み、特別な株主還元策として、1株当たり50円(中間配当25円、期末配当25円)としました。

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

スマートフォン等のモバイル端末に対する堅調な需要や、伸長するデータセンター向けサーバー需要を背景に、2013年後半からモバイルDRAM及びNANDフラッシュ向け設備投資が活発化しました。また、ロジック系半導体については、先端技術に対するファウンドリ等からの強い設備投資が継続しました。

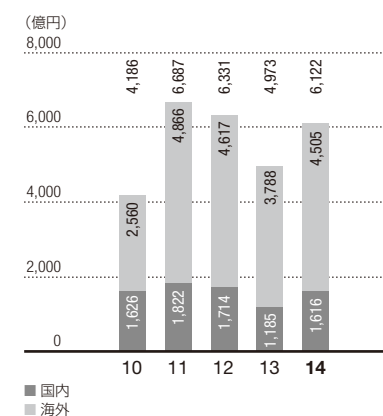
当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比22.1%増加の4,788億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高は、前期比22.1%増加の4,789億円、セグメント利益は前期比52.8%増加の743億円、セグメント利益率は前期の12.4%から15.5%に上昇しました。

当期の受注高は前期比59.7%増加の5,469億円、期末の受注残高は前期比48.2%増加の2,099億円となりました。

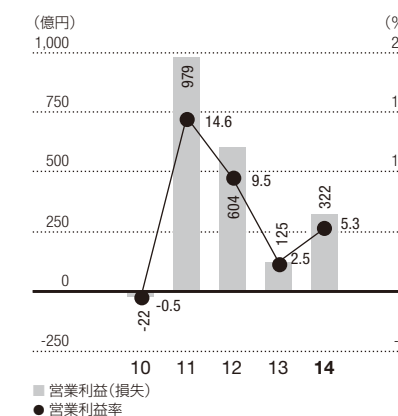
当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

損益状況	百万円				
	2010	2011	2012	2013	2014
売上高	¥418,637	¥668,722	¥633,091	¥497,300	¥612,170
売上総利益	108,316	234,758	211,445	158,755	201,892
売上総利益率	25.9%	35.1%	33.4%	31.9%	33.0%
販売費及び一般管理費	110,497	136,888	151,002	146,206	169,687
営業利益(損失)	(2,181)	97,870	60,443	12,549	32,205
営業利益率	(0.5)%	14.6%	9.5%	2.5%	5.3%
税金等調整前当期純利益(損失)	(7,768)	99,579	60,602	17,767	(11,756)
当期純利益(損失)	(9,033)	71,924	36,726	6,076	(19,409)

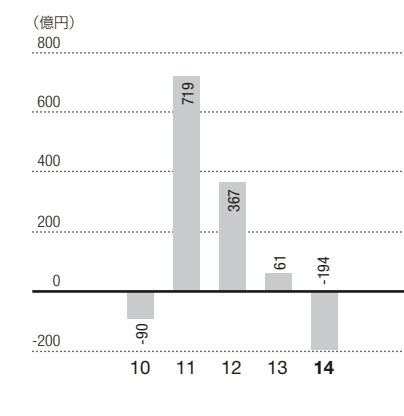
国内および海外売上高



営業利益(損失)および営業利益率



当期純利益(損失)



■ 財務概況

財務概況

■ FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

スマートフォン・タブレットに対する好調な需要を受け、高精細・中小型パネル向け設備投資は前年から引き続き堅調を維持しました。前年低調だったテレビ用大型パネル向け投資も2013年後半には中国を中心に回復のきざしが見えてきました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比41.0%増加の283億円となりました。また、セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も前期比41.0%増加の283億円となり、セグメント損失は前期の45億円から3千7百万円となりました。

当期の受注高は前期比88.9%増加の413億円、期末の受注残高は前期比81.3%増加の290億円となりました。当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

■ PV(太陽光パネル)製造装置

当社は、薄膜シリコン太陽光パネル市場への参入を目的として、2009年にスイスOerlikon Solar社と販売代理店契約を締結し、太陽光パネル用一貫製造ラインの販売活動を開始いたしました。2012年には同社を買収し、当社の製造装置技術と融合することにより事業成長を目指してまいりましたが、市場環境の変化によりパネルの生産設備は供給過剰状態が続きました。当社では変換効率向上に向けた開発強化及びコストダウンに最大限取り組みましたが、環境は依然として厳しく、今後の事業環境においても投資回収が見込めないと判断し、2014年3月末をもって同装置の製造開発、販売活動から撤退し、納入済

み装置に対するサポートのみを行う体制とすることを発表いたしました。これらに関連して当期にのれん及び固定資産の減損損失328億円を計上しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期の8千3百万円から38億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も前期の8千3百万円から38億円、セグメント損失は前期の18億円から464億円となりました。

当期の受注高は前期の8千3百万円から43億円、期末の受注残高は前期比6.8%増加の90億円となりました。当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

■ 電子部品・情報通信機器

2013年は、産業機器向けの部品需要が回復しました。電子部品事業においては、主にアジア地域における車載向けの部品需要の伸長を商権拡大により取り込み、汎用ICを中心に売上が伸長しました。また、情報通信機器関連事業においては、クラウドの普及を背景にデータセンター向け機器の売上が好調でした。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比19.0%増加の1,007億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含むセグメント売上高は、前期比19.1%増加の1,018億円、セグメント利益は前期比43.7%減少の7億円、セグメント利益率は前期の1.5%から0.7%に低下しました。

当部門の営業概況については、P9をご参照ください。

なお、当セグメントは東京エレクトロン デバイス株式会社及びその子会社が担っていましたが、当社および同社の今後の事業展開について検討した結果、従来以上にそれぞれの独自性を高めた成長戦略を構築することが、両社の企業価値向上に資すると判断し、2014年4月に当社の保有する同社株式の一部を売却いたしました。これにより、同社は2015年3月期より当社の連結子会社から持分法適用関連会社へ異動することとなり、今後当社に係る持分法投資損益はセグメント利益の調整額に含めて開示いたします。

■ その他

その他の売上は、当社グループの物流、施設管理および保険業務等の内部サービス関連業務の売上です。なお、当部門の外部顧客に対する売上高は、前期比7.0%増加の5億円となりました。

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

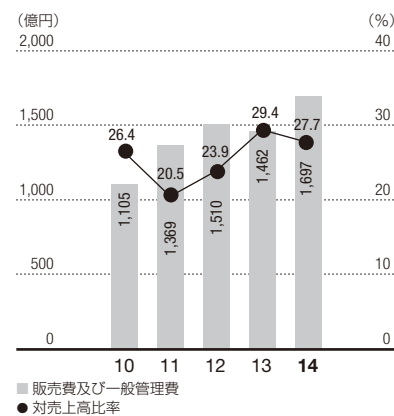
■ 資産

流動資産は、前期末に比べ1,000億円増加し、6,215億円となりました。主な内容は、たな卸資産の増加326億円、受取手形及び売掛金の増加285億円、手元流動性(現金及び現金同等物に短期投資を加えたもの)の増加280億円によるものです。なお、売上債権回転日数は前期の74日から77日にわずかに悪化、たな卸資産回転日数は前期から変わらず100日となりました。

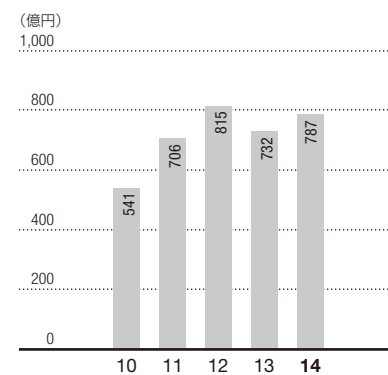
有形固定資産は、新規取得分が128億円ありましたが、減価償却実施額249億円、拠点再編計画に基づく固定資産の減損83億円等を差し引き、純額で234億円減少の1,123億円となりました。

セグメント情報	報告セグメント					合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD製造装置	PV製造装置	電子部品・情報通信機器	その他			
2014:								
売上高								
外部顧客への売上高	¥478,842	¥28,317	¥ 3,806	¥100,726	¥ 479	¥612,170	¥ —	¥612,170
セグメント間の内部売上高又は振替高	34	—	—	1,075	11,760	12,869	(12,869)	—
計	478,876	28,317	3,806	101,801	12,239	625,039	(12,869)	612,170
セグメント利益又は損失	74,284	(37)	(46,426)	722	1,267	29,810	(41,566)	(11,756)
セグメント資産	273,142	21,252	2,145	57,465	1,871	355,875	472,717	828,592
減価償却費	10,114	235	10	476	49	10,884	14,004	24,888
のれんの償却額	1,473	—	2,686	103	—	4,262	—	4,262
減損損失	5,009	—	32,789	—	—	37,798	9,171	46,969
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,109	103	857	825	41	9,935	5,109	15,044

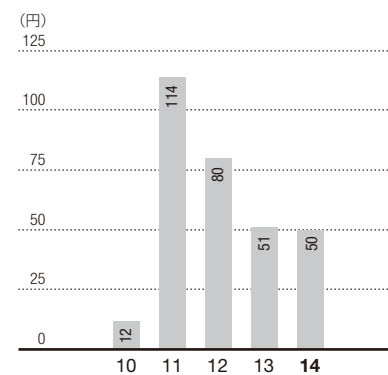
販売費及び一般管理費および対売上高比率



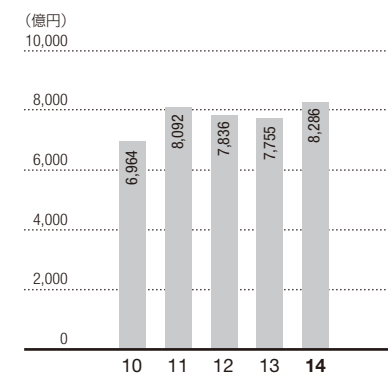
研究開発費



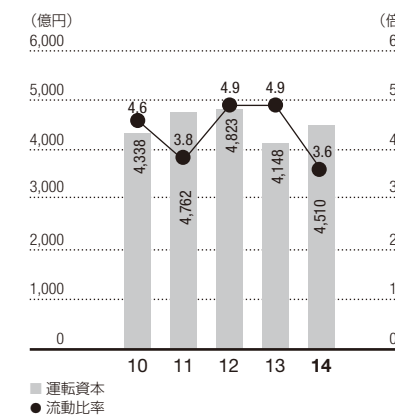
1株当たり配当金



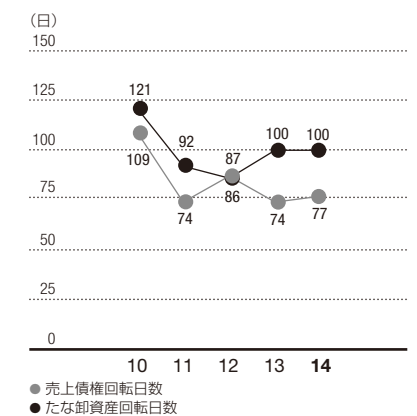
総資産



運転資本および流動比率



売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 財務概況

財務概況

投資その他の資産は、前期末から236億円減少し、948億円となりました。主としてPV製造装置事業及びTEL NEXX, Inc.の事業計画の見直しに伴う減損等によりのれんが290億円減少したことによるものです。

これらの結果、総資産は前期末から531億円増加し、8,286億円となりました。

■ 負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ638億円増加し、1,705億円となりました。主な増加要因は、前受金の増加209億円、支払手形及び買掛金の増加174億円、未払法人税等の増加117億円です。

長期負債は、長期繰延税金負債45億円の増加を主要因に、前期末に比べ37億円増加し、675億円となりました。

なお、当期より退職給付に関して、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しています。また、年金資産の額が退職給付債務を超過している場合は、退職給付に係る資産として、資産の部に計上しています。これにより当期末に

おいては、非拠出制の退職給付一時金制度について退職給付に係る負債540億円(前期は退職給付引当金572億円)、企業年金制度(キャッシュバランスプラン)について退職給付に係る資産89億円(前期は前払年金費用30億円)を計上しました。

当期末の長期・短期合わせた有利子負債残高合計は、東京エレクトロン デバイスの有利子負債の増加により、前期の38億円から135億円に増加し、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債/自己資本)は前期末比1.7ポイント上昇の2.3%になりました。

流動負債と長期負債を合わせた負債合計は、前期末に比べ676億円増加して2,380億円となりました。

純資産は、前期末に比べ145億円減少し、5,906億円となりました。主として、当期純損失194億円を計上したことによる減少、前期の期末配当47億円及び当期の中間配当45億円の実施による減少、連結子会社の決算期変更等による利益剰余金の減少32億円、円安による為替換算調整勘定の増加83億円、退職給付に係る調整累計額の増加70億円によるものです。

この結果、自己資本比率は前期から6.7ポイント低下し、69.8%となりました。一方、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の1.0%から-3.3%に低下しました。

設備投資額*および減価償却費**

当期の設備投資額は、前期と比較して41.2%減少の128億円となりました。主に、半導体製造装置事業およびFPD製造装置事業において、高成長が期待できる分野を中心に評価用機械装置等の取得を行いました。また、当社が東北大学において参画している次世代メモリSTT-MRAMの研究開発プログラム等に関連し、研究開発用機械装置等を取得しました。

減価償却費は前期と比較して6.5%減少し、249億円となりました。

* 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。
** 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比398億円減少の444億円となりました。主な内容として、

減損損失470億円、減価償却費249億円、前受金の増加191億円、支払手形及び買掛金の増加156億円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要因となり、税金等調整前当期純損失118億円、たな卸資産の増加321億円、受取手形及び売掛金の増加254億円がそれぞれキャッシュ・フローの減少要因となりました。

投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前期の1,418億円に対して196億円となりました。当期の支出は主として有形固定資産の取得による支出95億円、定期預金及び短期投資の純増加85億円によるものです。

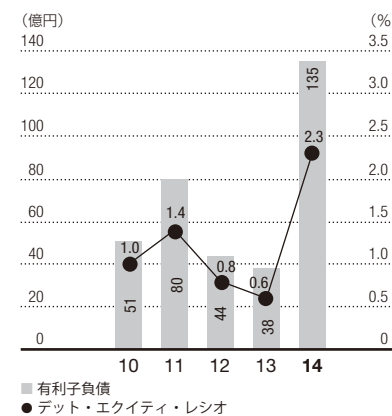
財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に短期借入の増加による収入76億円、長期借入の増加による収入20億円、配当金の支払91億円により、前期の106億円に対して2億円となりました。

現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ195億円増加し、1,048億円となりました。なお、現金及び現金同等物に短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末に比べ280億円増加し、2,681億円となりました。

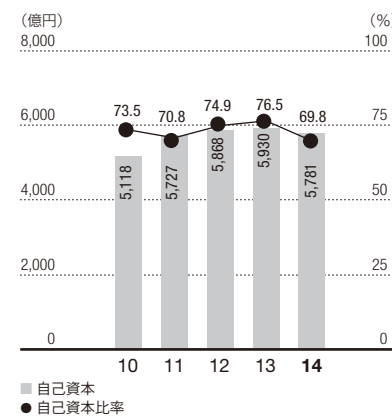
財政状態	百万円				
	2010	2011	2012	2013	2014
流動資産	¥552,939	¥644,231	¥607,051	¥521,501	¥621,492
有形固定資産	92,128	112,552	126,885	135,698	112,344
投資その他資産	51,285	52,422	49,675	118,329	94,756
総資産	696,352	809,205	783,611	775,528	828,592
流動負債	119,162	168,038	124,794	106,670	170,510
負債合計	172,982	224,403	185,008	170,401	237,978
純資産	523,370	584,802	598,603	605,127	590,614

キャッシュ・フロー	百万円				
	2010	2011	2012	2013	2014
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 48,285	¥ 83,239	¥ 29,712	¥ 84,267	¥ 44,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,613	(35,882)	(8,352)	(141,769)	(19,599)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(288)	(5,237)	(27,335)	(10,625)	(187)
現金及び現金同等物期末残高	123,940	165,051	158,776	85,314	104,797

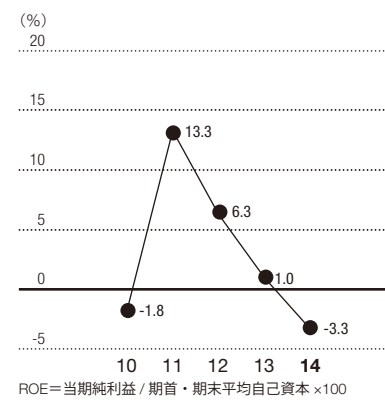
有利子負債および
デット・エクイティ・レシオ



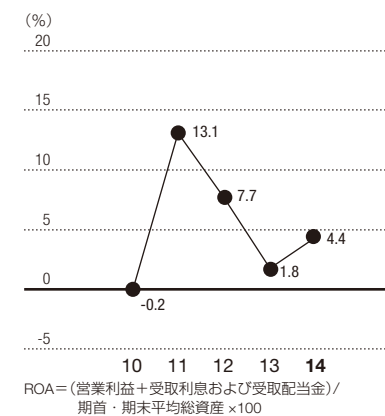
自己資本および自己資本比率



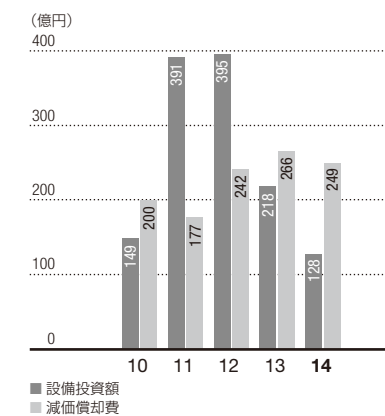
ROE



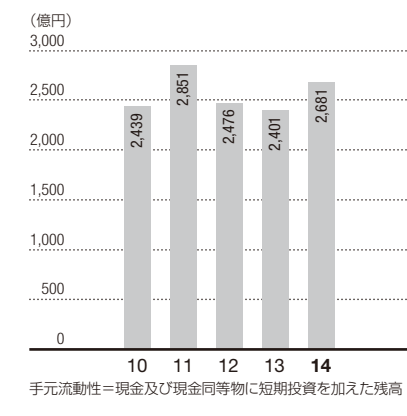
ROA



設備投資額および減価償却費



手元流動性



■ 財務概況

財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1)半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9)経営統合に関するリスク

当社は、2013年9月24日付で、アプライド マテリアルズとの間で対等な経営統合について合意し、経営統合契約を締結しました。現在、本経営統合に向けた準備を両社で進めておりますが、例えば、本経営統合に必要な関係当局の許認可等や承認が得られない、又は遅延する等、予定どおりに本経営統合が進まないリスク、何らかの事情により本経営統合の内容が変更となるリスク、本経営統合後においても、期待されるシナジー効果が十分に発揮されないリスク等が想定され、これらのリスクが顕在化した場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。